

Mikrofabrikation

Kategorie	Prozess	Gerät
Analytik		
	Impedanz-Spektroskopie	Solartron SI 1260 Impedanz Analyzer
	Optische Profilometrie	Keyence Laserscanning Mikroskop
	Profilometrie	Bruker DektakXT
	Schichtwiderstand	4-Spitzenmessplatz
	3D-Materialanalyse	FIB/SEM Zeiss Crossbeam 550; EDX Detector Zeiss Crossbeam 1540 mit Leica VCT100 cryo Zeiss Auriga 40
	Grenzflächenanalytik	Jeol ARM 200F High Resolution TEM/STEM mit CEOS Cs corrector
	Oberflächentopographie	Atomic Force Microscope Bruker Innova
	Lichtmikroskopsystem	Zeiss Axioimager Z2.M
	Lichtmikroskopsystem	Zeiss SmartZoom
Aufbau- und Verbindungstechnik		
	Drahtbonden	Drahtbonder DelvoTec 5610
	Flipchip	Fineplacer
	Kleben	Klebebank, Plasmareiniger, Dosiergerät
	Sägen (Si, Glas, Quarz)	Wafersäge Disco DAD3220
CVD (Chemical Vapour Deposition)		
	Parylene	Comelec C-30-H (Parylene / PECVD)
	SiN, SiO	Oxford Plasmalab 800 PECVD
Laserverfahren		
	Schneiden	LPKF ProtoLaser U Universal Laser Systems ULTRA R5000
	Schweißen	LPKF PowerWeld 2600 Eco
Lithographie		
	Belackung	Lackschleuder RC8 mit Hotplate Lackschleuder Convac SÜSS Gamma 4M Vollautomat
	Belichtung	Belichter SÜSS MA6 SÜSS MA200 Compact Vollautomat
	Entwicklung	SÜSS Gamma 4M Vollautomat
	Laminierung von Trockenfilmresist	Laminator SKY 335R6

Mikrofabrikation

Kategorie	Prozess	Gerät
Nassätzen & -verfahren		
	Flusssäure ätzen	Nassbank
	Mikrogalvanik (Au, Ni, ...)	Galvanik NBT
Polymer-Dünnschichtverfahren		
	Polyimid	Lackschleuder PI-Convac & Koyo Ofen
	Spin-coating PDMS	Lackschleuder Convac
PVD (Physical Vapour Deposition)		
	Sputterdeposition	Porta (verschiedene) Leybold Z 550 (Au, Pt, Cr, Ti) Leybold Z 700 (ITO, Ti, Ir) Leybold L560 (TiN)
Trockenätzen & Plasmabehandlung		
	Plasmabehandlung	Piccolo (O ₂ , N ₂ , Ar, SiO ₂ Abscheidung)
	Reactive-ion etching (RIE)	Oxford Plasmalab 800 (O ₂ , CF ₄)
	Trockenätzen	Leybold Z 550